

## 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东龙波先生持有公司股份 5,344,146 股，占公司总股本比例为 8.91%。截至本公告披露日，龙波先生持有本公司股份累计质押数量为 530,000 股（含本次），占其持股数量比例为 9.92%，占公司总股本比例为 0.88%。

● 龙波先生及其一致行动人持有公司股份 13,855,278 股，占公司总股本比例为 23.09%。截至本公告披露日，龙波先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为 2,565,000 股（含本次），占其合计持股数量比例为 18.51%，占公司总股本比例为 4.28%。

公司于 2024 年 6 月 6 日获悉，公司股东龙波先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。

### 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资金用途
龙波	是	530,000	首发限售股	否	2024年6月6日	2027年6月4日	国金证券股份有限公司	9.92	0.88	个人资金需求
合计	/	530,000	/	/	/	/	/	9.92	0.88	/

（注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。）

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次质押 前累计质 押数量 (股)	本次质押 后累计质 押数量 (股)	占其所持 股份比 例 (%)	占公 司总 股本 比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股 份中限售 股份数量 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押股 份中限售 股份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
崔学峰	8,511,132	14.19	2,035,000	2,035,000	23.91	3.39	2,035,000	0	6,476,132	0
龙波	5,344,146	8.91	0	530,000	9.92	0.88	530,000	0	4,814,146	0
合计	13,855,278	23.09	2,035,000	2,565,000	18.51	4.28	2,565,000	0	11,290,278	0

(注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。)

龙波先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年6月8日